

# ZUKEN digital

## SESSIONS 2025

10.20(月) - 11.13(木) オンライン開催

### ZUKEN digital SESSIONS とは？

#### 1. オンラインでいつでも視聴できる！豊富なプログラム

横浜で開催するZuke Innovation Worldでは、伝えきれない情報をオンデマンド配信します。

#### 2. 図研の製品・ソリューションの次なる展開を先取り

主力製品の開発ロードマップと最新ソリューションなどを一挙にご紹介します。

#### 3. 設計・検証・解析のエキスパートが語る！パートナー講演

パートナー企業の新たな取り組みや図研製品との連携ソリューションをいち早くお届けします。

視聴申込みは  
こちらから

<https://my.zukendigital.com/s/ziwzds/>



### 図研ビジョン

※本イベントの前週に開催した Zuken Innovation World 2025 横浜 での発表講演の録画動画をご覧ください。

#### ZV1 図研エンジニアリングITソリューションのビジョンとロードマップ2025

株式会社図研  
専務執行役員 技術本部長 仮屋 和浩



様々な分野で新テクノロジー台頭やサプライチェーン変動が進み、テクノロジーと経済の両面で不確実性の時代をむかえています。その中で、激動に適応するプロセス革新と合理化を両立すべく、図研はエンジニアリングにおける DX、設計製造における AI 活用、新たなテクノロジーへのチャレンジを進めています。図研の最新の取り組みとロードマップをご紹介します。

#### ZV2 モノづくり組織能力の再定義：図研が提言する、エンジニアリングDXの本質

株式会社図研  
専務執行役員 事業戦略担当 上野 泰生



不確実な時代を勝ち抜くため、製造業にはダイナミック・ケイパビリティの強化が不可欠です。図研は製造業各社の変革を支援するため、CAD や PLM に MBSE を統合した、新しいエンジニアリング環境を提案します。本セッションでは、このトータルソリューションがどのように企業の「強み」を再構築し、持続的な成長を可能にするのか、具体的な DX の方向性を示しながら解説します。

#### ZV3 図研ソリューションの進展と回路設計へのAI活用企画のご紹介

株式会社図研  
執行役員 事業本部長 藤原 宏行



近年の設計現場では、顧客要求の多様化・複雑化等により、性能・品質・コスト作り込みの難度が高まっています。本セッションでは設計起因のトラブルを予防するソリューションについて、昨年の発表への皆様のご関心と更なるお役立ちをご紹介します。また企画中の回路設計段階での AI 活用についていくつかの例をご紹介します。

### 10/30(木) 17時から「御礼・プレゼント抽選会」をライブ配信します。

抽選会当日までに、本オンラインイベントで1回でもアンケートにご回答いただいた方には当選のチャンスがありますので、是非ご視聴ください。

図研のビジョンを発表した執行役員 仮屋 和浩、上野 泰生、藤原 宏行がプレゼンターを務めます！

※この「御礼・プレゼント抽選会」はライブ配信となりますので配信時間帯以外では視聴することができません。ご注意ください。



### 新ソリューション企画

#### AF1 回路設計はもっと楽になる! エレキ検証をAIでナビゲート

株式会社図研  
事業本部 SE統括部 第一SE部 第一SE課  
チーフエンジニア 古川 和樹



「Design Gateway」や「Design Force」では、さまざまな検証機能をご提供しています。一方で、「どの検証が必要かわからない」「準備が煩雑」などの声もお聞きしています。

本セッションでは、AIを活用して有効な検証内容を提案し、その準備を支援する仕組みについて、構想中の案をご紹介します。

#### AF2 バリエーション設計を攻略! 「E<sup>3</sup>.series」を軸とした 受注設計プロセスの効率化

株式会社図研  
事業本部 SE統括部 第二SE部 名古屋SE課  
課長 山下 慎介



産業機械業界では、受注仕様に合わせた「ベース装置」へのアドオン設計が主流です。しかし、顧客要求の多様化により仕様が增大しているため、構成の見直しが進まず、仕様・CADデータ・PLM構成との不整合が発生しています。

本セッションでは、CADデータを基軸とした構成情報の連携手法とプロセスについて事例を交えてご紹介します。

#### AF3 MBSEと回路設計のすき間を埋める! 図研が拓く中間設計のアプローチ

株式会社図研  
DX戦略室  
井上 秋穂



性能や信頼性の基盤となるエレキ設計と製品全体の仕様の早期整合が不可欠になっている一方で、システム設計とエレキ設計間で情報の分断が発生し、仕様の不一致による手戻りが課題となっています。

本セッションでは、このような“すき間”を埋め、上流との仕様整合と回路設計への確実な引き継ぎを行う「中間設計ソリューション」をご紹介します。

#### AF4 共通化と多機種展開の両立! システム設計における バリエーション展開手法

株式会社図研  
DX戦略室  
室長 阿部 稔



多様な顧客ニーズへの対応が求められる中、個別開発の常態化により、リードタイムの長期化や派生開発時の手戻りが課題となっています。

本セッションでは、システム設計において、製品シリーズ内で共通する設計情報(150%モデル)から、機能や特性を指定することで製品バリエーション展開を行い、仕様の共通化と多機種展開の両立を実現する仕組みをご紹介します。

#### AF5 DXで制御ケーブル更新工事を革新! 接続情報のDB化とデジタル活用

株式会社図研  
事業本部 SE統括部 第二SE部 第三SE課  
課長 藤本 万也



近年、電力施設や工場設備は需要の拡大や設備の老朽化などで、更新工事が頻繁に発生しています。

更新工事における制御ケーブル設計は現状の接続状態を図面から読み取り、設計を進めることが多く、大変工数がかかり負荷が大きくなっています。

本セッションでは、図面から接続情報をデータベース化し、更新工事へ活用するソリューションをご紹介します。

#### AF6 ケーブルを含めたノイズ対策にも対応! 「3D EMC Adviser」の新ルール実演

株式会社図研  
事業本部 SE統括部 第一SE部 名古屋SE課  
主任 佐部利 亮輔



高性能化・高密度化・小型化が進む一方で、限られた期間でのノイズ対策が困難になっていませんか。

本セッションでは、「3D EMC Adviser」の最新動向をご紹介します。エレメカ融合したシステムレベルのノイズ対策について、拡張された検証ルールや開発中のケーブルに関するノイズ検証を通じて、どのような効果が見込めるかをご紹介します。

### 図研グループ会社

#### APA 統合BOM/BOPソリューション 「Visual BOM」のご紹介

株式会社図研プリサイト  
営業部  
部長 倉本 将光



「Visual BOM」は、統合BOMを管理・活用するためのPLMソリューションです。リリースから15年間、BOP(Bill of Process)管理による生産システム連携の強化など、ソリューションのカバー範囲を拡げ、多くのお客様に導入いただいております。

本セッションでは、製品概要、導入事例、開発予定の新機能をご紹介します。

#### APB 構想設計から試作検証まで伴走支援 図研テックの「EMC設計支援サービス」

図研テック株式会社  
事業統括部 第三事業所  
技術監督 古瀬 利之



図研テックの専任エンジニアが、構想設計から試作・検証まで、お客様の設計チームと一体となってEMC課題の解決を伴走支援する「EMC設計支援サービス」の具体的なサービス内容とお客さまへの適用事例をご紹介します。

また、設計者のスキル向上を支援するeラーニングサービス「eZラーニング」から「EMC設計講座」についてもご紹介します。

### ZUKEN digital SESSIONS 2025 開催期間

		10月										11月														
日付		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日

10:00~  
視聴開始

10/30 17:00~  
「御礼・プレゼント抽選会」ライブセッション

17:00  
視聴終了

### 製品開発ロードマップ

**R01 CR-8000 System Planner/Design Gateway ロードマップ**  
MBSE連携/モジュラーデザインなど上流設計との連携、自動設計に向けた取り組み

株式会社図研  
技術本部 EE開発部 部長 松下 哲郎  
技術本部 EE開発部 EE2セクション セクションマネージャー 遠藤 誠



高機能化・大規模化・複雑化が加速する製品開発においては、設計工程上流での品質のつくり込みがより重要となっています。本セッションでは、System Planner と Design Gateway を活用したモジュラーデザイン、MBSE 連携、サーキット DR 環境を中心に、回路設計領域における設計品質向上と設計効率化に向けた取組みとロードマップをご紹介します。

**R02 CR-8000 Design Force ロードマップ Part 1**  
システムレベル設計ソリューションの進化と設計業務革新

株式会社図研  
技術本部 EL開発部 部長 江草 大介  
技術本部 EL開発部 EL1セクション セクションマネージャー 佐藤 亮太



本セッションでは、EDAソリューションとして進化した Design Force について、Board Designer からの進化点に加え、システムレベル設計および解析主導型設計の実現に向けたアプローチを中心にご説明します。また、最新バージョンにおける機能・性能の強化点や、今後の製品ロードマップについてもご紹介いたします。

**R03 CR-8000 Design Force ロードマップ Part 2**  
3D EMC Adviser最新機能と解析モジュールAdvanceの紹介、エレメカ協調設計の機能拡張、解析連携強化

株式会社図研 技術本部 EL開発部 EL2セクション  
セクションマネージャー 吉島 憲輔



スマートEV や社会の多方面に AI 活用の活性化などが進む昨今、急速に社会環境の変化が進んでいます。デジタルリテラシーのある世代の増加に伴い、長年停滞していたデジタル化、ネットワーク化が一気に加速している状況にあります。本セッションでは、3D EMC Adviser などの最新機能の紹介に加え、図研の昨今の活動やそのコンセプト、ビジョンについてご紹介します。

**R04 CR-8000 Design Force ロードマップ Part 3**  
多様化する半導体パッケージ実装を支援するDesign Forceの半導体・パッケージ・MEMSソリューション

株式会社図研 技術本部 EL開発部 EL4セクション  
セクションマネージャー 菅谷 直之



先端半導体の開発は、チップレットによるノード最適化への期待から、製造装置、材料、インターポーザなど様々な技術革新が進み、弊社を取り巻くエコシステムや半導体パッケージ設計ツールへのニーズも変わりつつあります。これはパワー半導体やMEMS 設計環境も同様です。本セッションでは、これらに関連する新機能や図研の取組みをご紹介します。

**R05 CR-8000 Design Force ロードマップ Part 4**  
Autonomous Intelligent Place and Route 最新情報

株式会社図研  
技術本部 EL開発部 部長 江草 大介  
技術本部 EL開発部 EL1セクション シニアパートナー 生田 勝義



AI 技術を利用した自動配置配線ソリューションである Autonomous Intelligent Place and Route の設計効率化へのアプローチと、Design Force 2026 で計画している、過去資産を活かした自動設計機能である Dynamic Brain の最新情報およびリリース計画をご紹介します。

**R06 CR-8000 DFM Center ロードマップ**  
設計・製造DXおよび最先端基板製造を支援するDFM Center

株式会社図研  
技術本部 DFM開発部  
部長 弦間 一泰



DFM Center は生産準備業務が抱える労働力不足や技術継承といった課題へのDX ソリューションとして、設計から製造までをデジタルでつなぐプロセス最適化を進めています。本セッションでは、部品実装準備を効率化するDFM JISSO オプション、高機能化している半導体パッケージ・フレキシブル基板への対応を中心に最新機能およびロードマップをご紹介します。

**R07 DS-CR, DS-OP ロードマップ**  
システム回路・基板設計環境のデータ管理・プロセス管理、解析環境や他社ツールのデータ管理、PLM 連携

株式会社図研 技術本部PLM開発部  
副本部長兼部長 高木 良亮 パートナーセクションセクションマネージャー 深谷 匡洋



設計の上流から下流まで設計データを統合して、各プロセスでデジタルデータの活用を推進すべくDS-CR のカバレッジ拡大に取り組んでいます。CR-8000 や企業内で運用されているシステムの各種情報と連携して、電子機器設計を起点に設計・製造プロセスのDX を推進するDS-2 プラットフォームの最新リリースと今後のロードマップをご紹介します。

**R08 E<sup>3</sup>.series ロードマップ**  
マシナリー分野の制御/電装設計支援  
最新機能と製品開発ロードマップ

株式会社図研 技術本部 欧州開発統括室  
執行役員 欧州開発統括室長 早乙女 幸一



市場のグローバル化や多様化するニーズへの対応などにより産業機器・電子機器・工場 / プラントなどマシナリー制御 / 電装設計は益々高度化・複雑化しています。本セッションでは、マシナリー制御・電装設計工数を大幅に低減し、設計品質向上とDX 推進を可能とする E<sup>3</sup>.series の製品ロードマップと最新機能をご紹介します。

**R09 E<sup>3</sup>.infinite ロードマップ**  
トランスポート分野のワイヤーハーネス  
設計の自動化ならびに設計プロセス革新

株式会社図研 技術本部 A&M開発部  
部長 宇野 史朗 AM3セクション グループリーダー 川村 幸嗣



自動車業界は、SDV に代表される技術革新により大きな変革期を迎えています。一方で、開発期間の短縮や人材不足といった課題が深刻化しています。本セッションでは、図研が提案する次世代 E/E 設計ソリューション「E<sup>3</sup>.infinite」をご紹介します。ジェネラティブデザインによる設計自動化で、開発期間の短縮とコスト削減を両立する具体的な機能を、デモを交えてわかりやすく解説します。

**R10 DS-E3 ロードマップ**  
マシナリー/トランスポート各分野のワイヤハーネス  
設計環境に向けたデータ管理・プロセス管理、PLM連携

株式会社図研 技術本部 PLM開発部  
副本部長兼部長 高木 良亮 パートナーセクショングループリーダー 佐藤 佑介



電装設計プロセスにおける顧客要求への迅速な対応には、設計資産を有効活用し、設計情報を見える化して、効率的にバリエーション展開できることが求められます。CAD と連動した 150% BOM による仕向け / オプション管理や、更なる CAD との親和性を高めたエンベデッド環境など、DS-E3 の最新機能とロードマップをご紹介します。

**R11 MBSEソリューション GENESYSロードマップ**  
GENESYSを中心としたMBSEソリューションの  
最新機能、CR連携、SIDEKICK

株式会社図研  
技術本部 PI開発部  
セクションマネージャー 石井 則行



図研と Zuken Vitech 社が提供する MBSE ソリューションと MBSE モデリングツール GENESYS、および MBSE と CR-8000 設計環境との連携について最新機能とロードマップをご紹介します。さらに MBSE を活用した製品開発コラボレーションのための新ソリューション SIDEKICK をご紹介します。

### パートナー

#### AP1 ケーブルを含むEMC解析および放電・帯電現象解析のソリューションご紹介

アンシス・ジャパン株式会社  
技術部  
RF,EMI/EMC アプリケーションエンジニア 板谷 剛志 様



ケーブルのモデリングや大規模なモデルの電磁界解析において開発初期段階からの検討を実現する Ansys EMC Plus と、放電・帯電現象を取り扱うことが可能でプラズマやガスフローの高度なモデリングを実現する Ansys Charge Plus について、最新のバージョンまでで実装された新機能を交えてご紹介いたします。

#### AP2 航空宇宙産業向けMBSE活用事例 ~設計からシミュレーションによる検証まで~

アンシス・ジャパン株式会社  
技術部  
Lead Application Engineer Mr. Michael Haisma



現在、複雑化する製品開発において、モデルベースシステムズエンジニアリング (MBSE) は、革新的なアプローチとして注目を集めています。本講演では、山火事早期検知の衛星コンステレーションをテーマに、GENESYS を用いて MBSE プロセスを実現し、開発初期に構築したアーキテクチャの妥当性を ModelCenter を用いて検証するプロセスをご紹介します。

※GENESYSを用いたMBSEプロセスについては、株式会社図研 技術本部 PI開発部 パートナーセッション シニア・パートナー 高橋 修司より発表します。

#### AP3 シミュレーション効率化と設計資産を価値に変えるPCB検証の例

キーサイト・テクノロジー株式会社  
EDAソリューションエンジニアリング部  
ソリューションエキスパート  
小川 隼人 様 佐貫 聡信 様



設計者の悩みは時間が足りないことではないでしょうか。また、それにより設計品質にも影響を与えると考えます。本セッションではそういった問題を改善する例として CR-8000 Design Force と弊社ツール連携による高精度な PCB モデリング及びその解析と効率化、それら設計資産の活用方法をご紹介します。

#### AP4 Zuken DS-CRと 3DEXPERIENCE Platform 連携設計

ダッソー・システムズ株式会社  
技術部 SIMULIA  
テクニカル・マネージャー 大森寛康 様



図研様の CR-8000 とダッソー・システムズの 3DEXPERIENCE Platform の連携を実現する DS-CR を活用したワークフロー事例をご紹介します。設計者の利便性向上や部署間のデータ連携により、緊密で効率的な設計プロセスの構築の実現を支援します。

#### AP5 「設計図面コンバータ」と「E<sup>3</sup>.series for EC」の連携による電気工事設計のDX推進

横河電機株式会社  
デジタルソリューション統括本部 システム事業部  
事業センター 新事業開拓部 CXソリューション課  
池田 健太 様



人手による P&ID からの情報抽出は、ヒューマンエラーや業務負担の問題を抱えています。「設計図面コンバータ」は、図面上の各種シンボルを認識させることで図面情報のデジタル抽出が可能となり問題解決に大きく寄与します。本セッションでは、「E<sup>3</sup>.series for EC」と連携することで電気工事設計の DX 推進にも役立つ本製品をご紹介します。

※連携ソリューションについては、株式会社図研 事業本部 SE統括部 第二SE部の清水 優作より発表します。

#### AP6 試作に頼らないケーブル検証へ ~可動解析が実現する設計の次世代環境~

SCSK株式会社  
製造事業グループ デジタルエンジニアリング事業本部  
プロダクト技術部 第一課 シニアエンジニア 岸元 睦 様



「IPS Cable Simulation」は、設計段階でケーブルの剛性や自重を考慮し、最適な長さを導出できる唯一無二のケーブル解析ソリューションです。今年度、図研の「XVL Studio WR」との双方向連携を実現しました。製造データにミスなく・正しく反映し、試作レスと設計品質の向上を可能にします。

#### AP7 製造業のDXを3Dで加速する ~「XVL Web3D」で実現する3D情報流通~

ラティス・テクノロジー株式会社  
代表取締役社長CEO  
鳥谷 浩志 様



多くの企業は、組織間で情報が分断される「デジタル家内制手工業」の状況にあります。組織を超えた情報流通によってのみ、製造業の DX は成功します。本セッションでは、3D データ流通の基盤技術「XVL Web3D」の概要と、メカ設計の 3D データやエレキ情報を含むものづくりに必要な情報を統合して流通させることで成功した DX 事例を紹介します。

## ZUKEN digital SESSIONS 2025 開催期間

		10月										11月														
日付		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目	22日目	23日目	24日目	25日目

10:00~  
視聴開始

10/30 17:00~  
「御礼・プレゼント抽選会」ライブセッション

17:00  
視聴終了

### 10/30(木) 17時から「御礼・プレゼント抽選会」をライブ配信します。

抽選会当日までに、本オンラインイベントで1回でもアンケートにご回答いただいた方には当選のチャンスがありますので、是非ご視聴ください。

図研のビジョンを発表した執行役員 仮屋 和浩、上野 泰生、藤原 宏行がプレゼンターを務めます!

※この「御礼・プレゼント抽選会」はライブ配信となりますので配信時間帯以外では視聴することができません。ご注意ください。

